

ネプコンジャパンでのノイズ設計/熱設計セミナーのご案内

当社は、2025年1月に東京ビッグサイトにて開催されるエレクトロニクス製造・実装・検査に関するアジア最大級の専門展示会『第39回インターネプコンジャパン<エレクトロニクス製造・実装展>』にグループ会社である「アルティメイトテクノロジーズ(株)(略称:UTI社)」と共同出展いたします。

本会場にてUTI社/中村CTOが、ノイズ設計/熱設計に関するセミナーを実施いたします。ネプコンの来場登録(無料)のみで、予約不要でどなたでも聴講可能です。ご興味のある方はぜひご参加ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

<セミナー 概要>

- ・日時: 2025年1月24日(金) 14時~14時30分
- ・場所: 東京ビッグサイト 東3ホール「新製品・新技術セミナー~New Tech Trend~」
- ・セミナータイトル: 機器のノイズ設計/熱設計は、PCBの電流分布(AC/DC)把握から
- ・セミナー講師: アルティメイトテクノロジーズ(株) 中村 篤CTO
- ・セミナー内容: SW素子の低オン抵抗化、並列使いで、PCBパターンの発熱が無視できなくなっています。大電流を流す基板では、つい幅広、厚銅に対策を求めがちですが、電流経路(分布)の偏りに着目することで、パターン発熱が抑えられることがあります。発熱対策にも踏み込んだ当社の熱設計、解析技術と、放熱経路の考え方(熱回路網法*)をご紹介します。
- ・アルティメイトテクノロジーズ(株): <https://www.uti2k.com/>

<ネプコンジャパン 概要>

- ・日時: 2025年1月22日(水)~24日(金) 10:00~17:00
- ・場所: 東京ビッグサイト 東ホール
 - >> 当社ブース: EMS/製造受託ゾーン「小間番号:E10-42」
- ・来場登録: 以下URLよりご登録ください。
 - >> <https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1215028825716956-UA1>

<問合せ先>

東京本社 経営企画部(松本) TEL:03-5683-7000